



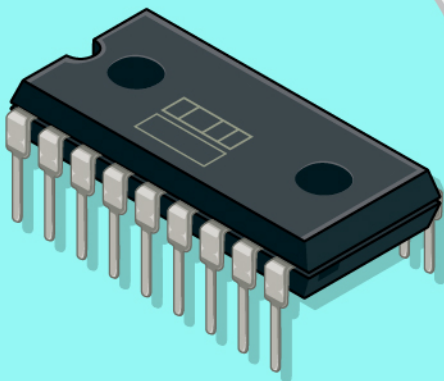
TIPOS DE TECNOLOGÍA EN MICROCHIPS

Existen dos tipos de tecnologías en el diseño de microchips que dependen de su montaje y que debes conocer para reparar los equipos de cómputo

THT *Through-Hole Technology*

Son componentes, grandes o medianos, que tienen que atravesar la tarjeta de circuito impreso o PCB para que puedan montarse, con el fin de poder ser soldados por la parte inferior de la placa.

Las características de esta tecnología son:



Para hacer pasar a los componentes a través de la placa se tiene que perforar haciendo el proceso un poco más costoso.

Los componentes THT generalmente son más fáciles de conseguir.

Los prototipos caseros de circuitos impresos generalmente están diseñados con este tipo de tecnología.

Sus circuitos son por lo regular más grandes.

Sus componentes son más sencillos de soldar, pero difíciles de retirar.



TIPOS DE TECNOLOGÍA EN MICROCHIPS

SMT

Surface Mount Technology

Son componentes pequeños o milimétricos que no tienen que atravesar la PCB para que se puedan montar. Éstos se sueldan del mismo lado de la placa en el que están.

Las características de esta tecnología son:

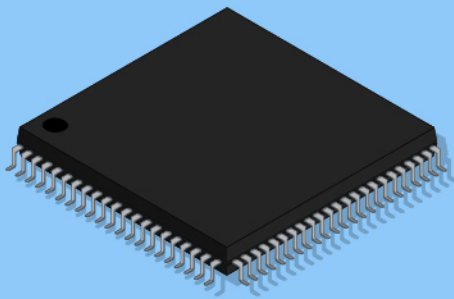
Las PCB son, por lo regular, más baratas, ya que no se tienen que perforar grandes hoyos.

Los componentes SMT generalmente son más difíciles de conseguir.

Los prototipos caseros son poco comunes.

Sus circuitos son, por lo regular, más pequeños.

Los componentes SMT son difíciles de soldar, pero más sencillos de retirar.



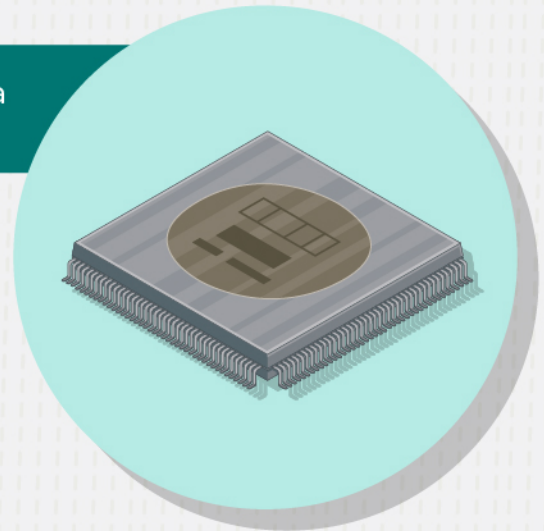


Los componentes SMT tienen dos variaciones:

SMD

Surface Mount Device

Tienen los pines de conexión de forma lateral para facilitar su montaje.



Ball Grid Array

BGA

Tienen sus pines de conexión debajo del mismo, por lo que su montaje sólo se puede realizar en hornos especiales. Esta solución es común en microprocesadores o procesadores de gráficos, los cuales tienen demasiados pines de conexión.

